

この資料は英語版を翻訳したもので、内容に相違が生じる場合には原文を優先します。こちらの日本語版は参考用としてご利用ください。設計の際には、最新の英語版で内容をご確認ください。

SIII51017-1.1

はじめに

この章では、アルテラの Stratix[®] III デバイスのパッケージ情報を提供しています。内容は以下のとおりです。

- デバイスとパッケージのクロス・リファレンス
- 熱抵抗値
- パッケージ形状

表 17-1 に、FineLine BGA[®] (FBGA) パッケージで提供されている Stratix III デバイスを示します。

表 17-1. Stratix III デバイスのパッケージ一覧 (1 / 2)		
デバイス	パッケージ	ピン
EP3SL50	FineLine BGA - Flip Chip	484
	FineLine BGA - Flip Chip	780
EP3SL70	FineLine BGA - Flip Chip	484
	FineLine BGA - Flip Chip	780
EP3SL110	FineLine BGA - Flip Chip	780
	FineLine BGA - Flip Chip	1152
EP3SL150	FineLine BGA - Flip Chip	780
	FineLine BGA - Flip Chip	1152
EP3SL200	FineLine BGA - Flip Chip	780
	FineLine BGA - Flip Chip	1152
	FineLine BGA - Flip Chip	1517
EP3SL340	FineLine BGA - Flip Chip	1152
	FineLine BGA - Flip Chip	1517
	FineLine BGA - Flip Chip	1760
EP3SE50	FineLine BGA - Flip Chip	484
	FineLine BGA - Flip Chip	780
EP3SE80	FineLine BGA - Flip Chip	780
	FineLine BGA - Flip Chip	1152
EP3SE110	FineLine BGA - Flip Chip	780
	FineLine BGA - Flip Chip	1152

デバイス	パッケージ	ピン
EP3SE260	FineLine BGA - Flip Chip	780
	FineLine BGA - Flip Chip	1152
	FineLine BGA - Flip Chip	1517

熱抵抗

Stratix III デバイスの熱抵抗仕様は、「Stratix Series Device Thermal Resistance Data Sheet」を参照してください。

パッケージ形状

Stratix III デバイスのパッケージ形状は、アルテラのウェブサイトの[デバイス・パッケージ詳細](#)ページからダウンロードすることができます。

改訂履歴

表 17-2 に、本資料の改訂履歴を示します。

日付 & ドキュメント・バージョン	変更内容	概要
2007 年 5 月 v1.1	熱抵抗とパッケージ形状の情報を削除し、この情報の参照先を記載。	マイナー・アップデート。
2006 年 11 月 v1.0	初版	—